

国机精工集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026—041

投资者关系 活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 电话会议 ☐ 其他
参与单位名称 及人员姓名	中信证券：闵睿 国信证券：康睿强 国新证券：穆哈 中国人民养老保险：于文博 前海人寿：吴希凯
时间	2026 年 10 月 16 日
地点	国机精工会议室
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书：赵祥功 投资者关系助理：汪智婷
投资者关系活 动主要内容介 绍	1. 问：超硬材料磨具业务在半导体领域的开展情况？ 答：近几年，得益于我国半导体产业的发展，公司应用在半导体领域的产品保持较快增长势头，上半年同比增速约 40%，未来增长空间大。公司已形成“金刚石工具+精密陶瓷制品”的产品布局，覆盖倒边轮、减薄砂轮、划片刀、封装刀及陶瓷载盘、陶瓷吸盘、真空卡盘、静电卡盘等产品，贯穿半导体晶圆制造到封装测试全流程，客户覆盖国内主流晶圆厂、封测厂与设备厂商。依托技术积淀与本土化服务优势，公司高端产品持续突破，国产替代进程不断加快。 2. 问：金刚石散热主流产品类型及市场如何比较？ 答：行业内主流产品分为单晶金刚石散热片、多晶金刚石散热片和金刚石铜复合材料三大类。单晶金刚石散热片热导率约 2000W/m·K 以上；多晶金刚石散热片的热导率约 1500W/m·K；金刚石铜复合材料热导率约 800W/m·K。市场主要从生产成本、生产工艺、下游适配场景等维度综合评估。 3. 问：公司在金刚石功能化应用业务上有何优势？ 答：金刚石功能化应用是公司面向未来的战略赛道，目前已覆盖

	单晶金刚石、多晶金刚石、金刚石铜复合材料三条技术路线与产能布局，整体处于行业先进水平。 装备端自主可控，公司 MPCVD 设备全部自研自制，拥有新型高功率 MPCVD 法大尺寸金刚石生产线。标准端引领行业，牵头编制国内首个《热沉用金刚石片》团体标准，填补行业技术规范空白。应用端持续突破，散热片、光学窗口片等产品已配套国防领域重大工程；民用领域覆盖高功率芯片、IGBT（晶体管）、消费电子等应用场景，相关产品正与下游头部客户开展合作验证。产业化支撑同步夯实，稳步推进产业园建设。 4. 问：公司金刚石工具业务的情况？ 答：公司在半导体领域金刚石工具产品上处于行业领先地位，主要包括划片刀、封装刀、减薄砂轮等产品，用于晶圆减薄、芯片划切与封装测试环节，是目前公司超硬磨具业务最核心的增长来源。不过公司该类产品与海外龙头仍存在差距，将持续加大技术研发投入，迭代优化产品性能与生产工艺。 5. 公司业务未来重点发展方向是什么？ 答：超硬材料板块，一是聚焦半导体耗材国产化赛道，着力推动金刚石工具持续放量，加快突破精密陶瓷制品高端市场，持续提升国产替代渗透率。二是重点发展功能化应用金刚石，加快装备迭代升级，持续优化 MPCVD 生长工艺与制备技术，实现大尺寸单晶、多晶金刚石材料技术突破，优化金刚石铜复合材料工艺，全面推进功能金刚石产业化进程。 轴承板块，巩固航天领域技术领先优势，保障国家重点工程需求；深度布局商业航天赛道，加快可回收火箭相关轴承研发与产业化步伐。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文	无

档等附件（如有，可作为附件）	
----------------	--